

Title (en)

Process for skiving workpieces and skiving machine.

Title (de)

Verfahren zum Schärfen von Werkstücken und Schärfmaschine.

Title (fr)

Procédé pour parer des pièces à travailler et machine à parer.

Publication

**EP 0427156 A2 19910515 (DE)**

Application

**EP 90121080 A 19901103**

Priority

DE 3937395 A 19891110

Abstract (en)

A process serves to skive flap-like workpieces made of leather or artificial leather. A skiving machine (10) used for this purpose has a feed roller (15), at least one guide element (13, 14) and a bell-shaped blade (12) for transporting and guiding the workpieces. Servomotors serve to adjust the feed roller (15) and the guide element (13, 14). An electronic control unit (40) contains a memory for storing sets of setting values, corresponding to cross-sectional shapes, for setting the servomotors. A keyboard (37) serves, among other things, to address memory locations of the memory. A measuring device (40) contains means for detecting a thickness of the workpiece. The measuring device (40) produces a digital signal corresponding to the thickness. The measuring device (40) is connected to a first address line of the memory. <IMAGE>

Abstract (de)

Ein Verfahren dient zum Schärfen von lappenartigen Werkstücken aus Leder oder Lederersatzstoffen. Eine hierzu verwendete Schärfmaschine (10) weist eine Vorschubwalze (15), mindestens ein Führungselement (13, 14) und einen Glockenmesser (12) zum Transportieren und Führen der Werkstücke auf. Servomotoren dienen zum Verstellen der Vorschubwalze (15) und des Führungselementes (13, 14). Ein elektronisches Steuergerät (40) enthält einen Speicher zum Speichern von Querschnittsformen entsprechenden Sätzen von Einstellwerten für die Einstellung der Servomotoren. Eine Tastatur (37) dient u.a. zum Adressieren von Speicherplätzen des Speichers. Eine Meßeinrichtung (40) umfaßt Mittel zum Erfassen einer Dicke des Werkstücks. Die Meßeinrichtung (40) erzeugt ein der Dicke entsprechendes Digitalsignal. Die Meßeinrichtung (40) ist mit einer ersten Adreßleitung des Speichers verbunden.

IPC 1-7

**B26D 1/12**; **B26D 3/02**; **B26D 5/00**; **C14B 1/22**

IPC 8 full level

**B26D 1/12** (2006.01); **B26D 3/02** (2006.01); **B26D 5/00** (2006.01); **C14B 1/22** (2006.01)

CPC (source: EP)

**B26D 1/12** (2013.01); **B26D 3/02** (2013.01); **B26D 5/00** (2013.01); **C14B 1/22** (2013.01)

Cited by

EP0707079A1

Designated contracting state (EPC)

DE FR GB IT

DOCDB simple family (publication)

**EP 0427156 A2 19910515**; **EP 0427156 A3 19911016**; **EP 0427156 B1 19950906**; DE 3937395 C1 19910508; DE 59009621 D1 19951012

DOCDB simple family (application)

**EP 90121080 A 19901103**; DE 3937395 A 19891110; DE 59009621 T 19901103